

KDB TechConnect Day 개최 안내

전략적 투자유치 · 제휴 희망기업을 찾습니다

한국소재부품장비투자기관협의회(주)제타플랜인베스트·KDB산업은행은 국내 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화의 일환으로, 대·중견기업의 네트워크, 자금과 스타트업의 기술, 아이디어가 결합되는 전략적 제휴를 지원하기 위하여 공동으로 "KDB TechConnect Day"를 개최합니다.

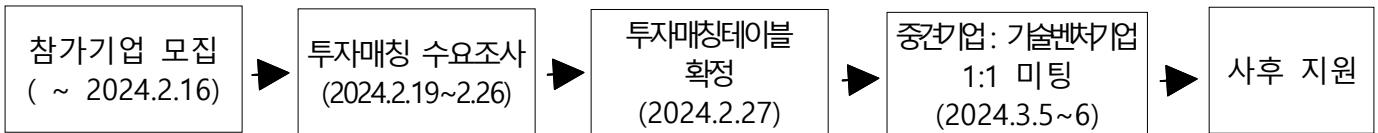
전략적 투자유치 또는 제휴를 희망하는 **소재·부품·장비** 기술의 스타트업은 대·중견기업의 투자희망 기술분야를 참조하여 첨부된 신청서로 많은 참여를 부탁드립니다.

□ 대·중견기업의 투자희망기술 분야

참여 대·중견기업* 분류	투자희망기술 분야
소재·화학 (이녹스, 노루페인트, 조광페인트 등)	1. 반도체, 차세대 디스플레이 및 기타 IT向 첨단 소재 2. 2차전지 소재 및 사용 후 진단, 재활용, 안전 기술 3. 기능성 코팅 소재, 점·접착제용 소재 및 친환경 페인트
부품·장비 (비에이치, 진성티이씨, HL홀딩스, 한국무라타전자 등)	1. 스마트폰, 디스플레이, 2차전지, 자동차 전장용 부품 2. 로봇 및 인공지능을 활용한 자율주행 3. 반도체 패키징, 팹리스 기술 3. 물류 최적화 및 효율화 기술

※ 미팅 희망기업이 없을 경우, 불참할 수도 있음

KDB TechConnect Day 추진 일정



- 문 의 KDB산업은행 넥스트라운드실 임창도 파트장(02-787-6166, cdihm@kdb.co.kr)
한국소재부품장비투자기관협의회 윤한준 연구원(02-6000-7950, hjyun@kitia.or.kr)
(주)제타플랜인베스트 권혁장 이사(070-8129-5884, zetabiz@zetaplan.com)
- 신 청 첨부된 신청서 작성 후 cdihm@kdb.co.kr로 e-mail 접수
- 미팅일시 **2024년3월5일~6일** 10시~18시(1회 미팅은 약 1시간 예정)
- 미팅장소 산업은행 본점 1층 고객접견실(여의도 국회의사당역 인근)
- 협력기관 한국기술벤처재단, 한국발명진흥회, (주)에스와이피
- 주의사항 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다

※ 참가희망기업이 첨부된 신청서로 담당자에게 신청하시면, 투자 수요조사를 통해 효율적인 매칭이 이루어지도록 하겠습니다. 매칭이 이루어지지 않는 경우, 미팅에 참석이 불가하나 행사 후 다른 대·중견기업과의 상담을 추진하겠습니다. 감사합니다^^.